

RJ45C5E S1U DE4N RL

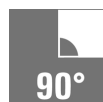
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:

- 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
- górny zatrzask / dolny zatrzask
- Procesy lutowania THT, THR lub SMD
- Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z wbudowanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu
- Kategoria działania Cat. 3 do Cat. 6
- Pakowane na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)
- Kompatybilny ze złączem modułowym RJ45, zgodnie z ANSI / TIA-1096-A oraz IEC 60603
- Wytrzymałość dielektryczna ≥ 1500 V AC RMS (wartość szczytowa 2250 V AC) zgodnie z IEEE 802.3
- Wytrzymałość dielektryczna ≥ 1500 V AC (wartość szczytowa) lub ≥ 1500 V DC zgodnie z IEC 60603

Właściwości i zalety:

- Rozszerzony zakres temperaturowy od -40° degC do $+85^{\circ}$ degC dla maksymalnej wydajności
- Wzmocniona warstwa złota (30μ) dla lepszego zabezpieczenia przed korozją
- Odstęp minimum 0,3 mm zapewnia idealne rezultaty lutowania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe do druku, Gniazda RJ45, Cat. 5e , Przyłącze lutowane SMD, 90°, Opcja zatrzaskiwania: góra, Zaciski ekranu: 6 tabs, 30...80 μ Ni / ≥ 30 μ Au , LED: Nie, Liczba biegunów: 8, Tape
Nr zam.	2562940000
Typ	RJ45C5E S1U DE4N RL
GTIN (EAN)	4050118571967
Ilość	200 Szt.
opakowanie	Tape

RJ45C5E S1U DE4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	15,7 mm	Głębokość (cale)	0,618 inch
Wysokość	14,71 mm	Wysokość (cale)	0,579 inch
Najmniejsza wysokość montażu	13,41 mm	Szerokość	18,8 mm
Szerokość (cale)	0,74 inch	Masa netto	0,009 g

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at	Prąd znamionowy	1,5 A
Wytrzymałość izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$	Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	1500 V DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V DC	napięcie znamionowe	125 V

Specyfikacje systemu

Cykle wpinania	750
Długość kołka lutowniczego (l)	3,05 mm
Ekranowanie	Tak
Kategoria	Cat. 5e
Klasa mocy	Cat. 5e
LED	Nie
Liczba biegunów	8
Materiał ekranu	mosiądz
Okablowanie	8-żyłowy
Opcja zatraskiwania	górną
Powierzchnia ekranu	niklowany
Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczny
Raster w calach (P)	0,05 "
Raster w mm (P)	1,27 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane SMD
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazdo modułowe RJ45
Stopień ochrony	IP20
Tolerancja długości kołka lutowniczego	Dolny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza mi- nimum) -0,15
	Górny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza maksimum) +0,15
	Tolerancja, jednostka mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego	+0,15 / -0,15 mm
Tolerancja pozycjonowania kołka lutowniczego	$\pm 0,1 \text{ mm}$
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)	$\pm 0,1 \text{ mm}$
Współpłaszczyznowość:	100 μm
Wymiary kołka lutowniczego	ośmiokątny
Zaciski ekranu	6 tabs
kąt odejścia	90°
liczba kołków lutowanych na biegun	1
montaż na płytce drukowanej	Przyłącze lutowane SMD
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	0,9 mm

RJ45C5E S1U DE4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 9T	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	grupa materiałów izolacyjnych	II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 500	Wytrzymałość izolacji	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
podstawowy materiał styku	Fosforo-brąz	Materiał styków	Stop Cu
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Struktura warstwowa wtyku	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura magazynowania, max.	85 °C
Temperatura pracy, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	85 °C

Opakowanie

opakowanie	Tape	Długość VPE	330 mm
Szerokość VPE	330 mm	Wysokość VPE	48 mm
Średnica rolki taśmy Ø (A)	330 mm	Odporność powierzchni	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Certificate of Compliance
Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

RJ45C5E S1U DE4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



RJ45C5E S1U DE4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

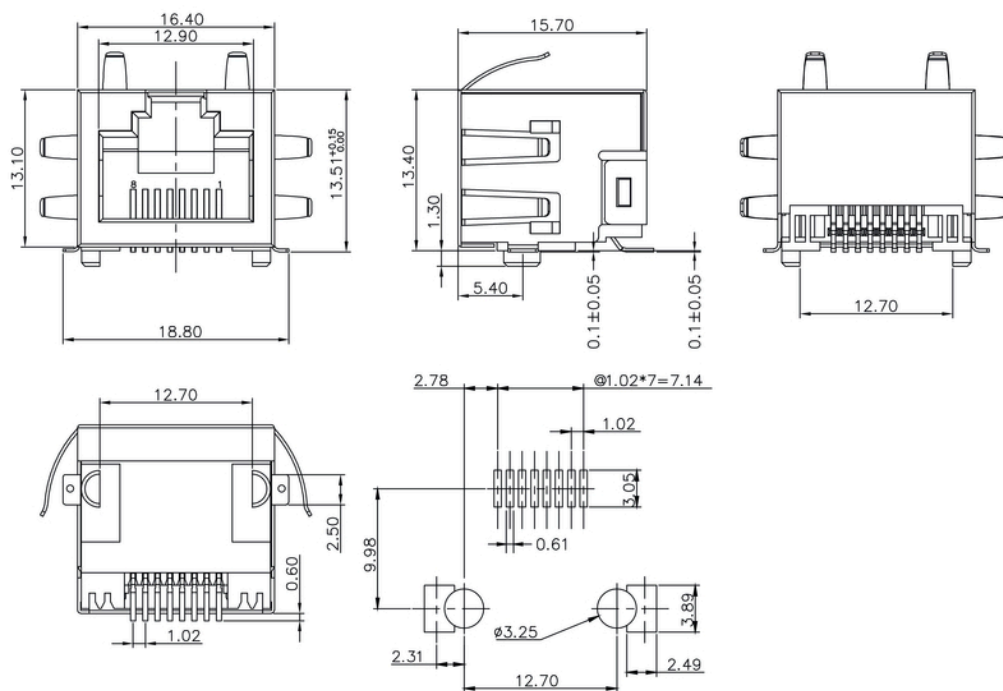
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowany



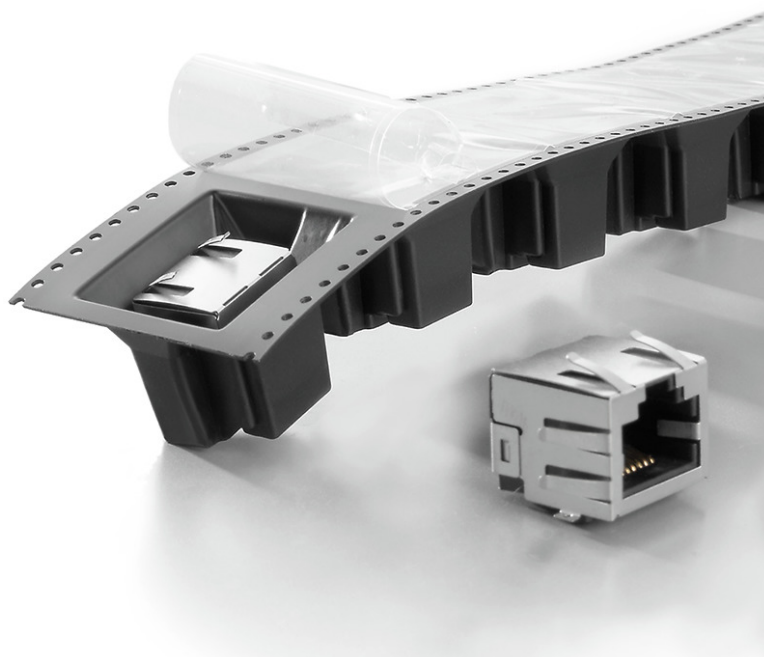
RJ45C5E S1U DE4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Zalety produktu



Process-optimised packaging
Tape-on-reel or tray

RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
										Packaging
										TY
										RL
										Tray in box (manual assembly)
										Tape on Reel (automated assembly)
										LED
										Y/G
										Yellow/Green
										G/Y
										Green/Yellow (standard)
										GY/GY
										Green-Yellow/Green-Yellow
										O/G
										Orange/Green
										R/O
										Red/Orange
										... (further combinations possible)
										N
										without LED
										Contact surface thickness
										4
										1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
										EMI tabs (ground fingers)
										E
										E = with EMI tabs
										N
										N = without EMI tabs
										Solder Pin length
										3.2
										3.2 mm
										1.6
										1.6 mm
										D
										SMD
										Direction, latch style
										U
										Horizontal (90°, side entry), latch up
										D
										Horizontal (90°, side entry), latch down
										V
										Vertical (180°, top entry)
										Y
										Diagonal (45°), latch up
										Number of Ports
										1
										1 Port
										12; 14; ...
										multi ports side by side, Multiport
										2; 4; ...
										multi ports about each other, Multilevel
										Assembly on PCB
										R
										Through Hole Reflow - THR
										Soldering process: Wave or Reflow soldering
										S
										Surface Mount Technology - SMT
										Soldering process: Reflow soldering
										T
										Through Hole Technology - THT
										Soldering process: Wave
										Performance Category
										C5
										Category 5
										C6
										Category 6
										C6A
										Category 6A
										C5e
										Category 5e
										M
										10/100 Mbit
										G1
										10/100/1000 Mbit
										G10
										10 Gbit
										U
										Unshielded
										MP
										10/100 Mbit with POE
										MP+
										10/100 Mbit with POE+

Legenda

Data sporządzenia 6 czerwca 2024 12:04:54 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.